

半導体分野における法環境の急変 ～アメ（助成金）とムチ（輸出管理）～



森・濱田松本法律事務所
シニア・アソシエイト
大川 信太郎

激化する米中対立を受けて、半導体分野における法環境は急激に変化している。自国のサプライチェーンを強靱化するためのアメ（助成金）と自国の技術流出を防止するムチ（輸出管理）が同時に採用されており、半導体分野の企業としては、アメをうまく使いつつ、ムチの影響を最小化する企業戦略が求められる。

本稿では、主要なポイントに絞って、半導体分野を巡る近時の日米の法律の動向を概観したい。

I. 半導体分野のアメ

半導体分野では、日米に限らず世界各国で助成金合戦が繰り広げられている。

その背景には、世界的な半導体不足に伴い、自国に半導体サプライチェーンを維持することの重要性が認識されてきたことがあげられよう。自国に半導体サプライチェーンを維持することは、産業政策として重要であるとともに、経済安全保障の観点からも重要になる。すなわち、小林前経済安全保障担当大臣の国会答弁^{注1}では、一般論である旨を留保しつつ、①経済構造の自律性確保、②技術の優位性・不可欠性の確保、③普遍的な価値やルールに基づく国際秩序の維持強化の3つの目標のために、経済的な施策を総合的かつ効果的に推進していくことが、現在内閣で取り組まれている経済安全保障の中心にある考え方であると説明されているが、自国の産業にとって死活的な半導体サプライチェーンを維持することは、経済構造の自律性確保の観点から重要視される。

別の背景としては、高性能半導体は各技術分野におけるゲームチェンジャーとなり得ることを前提に、自国の技術的な優位性を確保することが経済安全保障の観点から必要であることがあげられる。すなわち、上記3つの目標のうち②技術の優位性・不可欠性を確保することで、他国から不当なエコノミック・ステイトクラフト（国家が対外政策の目的を達成するために経済

的手段を用いること）の対象とされないよう自衛する側面がある。

しかし、企業としては、アメには紐がついている点に注意する必要がある。すなわち、助成金は一定の企業活動の制限を条件とする場合があり、アメを取る前に損得を勘定する必要がある。

1. 日本における半導体分野の主要な助成制度

半導体分野における主な助成制度としては、5G法（特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律）に基づくものと、経済安全保障推進法（経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律）に基づくものがあげられる。

5G法では、特定半導体（5G情報通信システムに不可欠な大量の情報を高速度で処理することを可能とするもので、国際的に生産能力が限られている等の事由により国内で安定的に生産することが特に必要なもの）等について、生産施設の整備および生産を行う計画を認定し、認定事業者に対して助成金等の支援策が講じられる。すなわち、高性能な半導体等のみを支援の対象としている。本稿脱稿日時点では、Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社等（最大助成額：4760億円）、キオクシア株式会社等（最大助成額：929.3億円）、マイクロンメモリ ジャパン株式会社等（最大助成額：464.7億円）が支援の対象とされている。

経済安全保障推進法では、特定半導体以外の従来型半導体（パワー半導体、マイコン、アナログ）、半導体製造装置、半導体部素材、半導体原料（黄リン・黄リン誘導品、ヘリウム、ネオン・クリプトン・キセノン、蛍石・蛍石誘導品）について、安定供給確保計

画の認定を受けた事業者に対して、生産施設・生産設備等に関する助成金等の支援策が講じられる。すなわち、5G法が先端半導体を支援するのに対し、経済安全保障推進法ではレガシーまで含めた支援が行われている。

5G法・経済安全保障推進法ともに、あからさまな条件は付されていないものの、実際申請にあたっては、供給先やサプライチェーンの情報が求められることがあり、仮に助成金を受けて製造した半導体等を日本と安全保障上の緊張関係にある国に供給するような場合には、認定がされない恐れがあり、また供給確保計画に沿った事業を行っていないとして事後的に認定が取り消される恐れがある。

2. 米国における半導体分野の主要な助成制度

米国における半導体分野の主要な助成制度としては、トランプ政権下で成立したCHIPS法（CHIPS for America Act）とCHIPS法の予算措置を含むバイデン政権下で成立したCHIPSプラス法（CHIPS and Science Act）があげられる。

CHIPS法では、5G法や経済安全保障推進法同様に、一定の半導体分野に対して助成金が交付される。第一弾の助成金は、レガシー半導体を含む半導体製造施設を対象としており、第二弾の助成金は半導体材料・半導体製造装置の製造施設を対象としている。

助成金の交付を受けるものは各種条件に従う必要があるが、特に注目すべきは「ガードレール条項」といわれるロシア・中国等の懸念国への一定以上の投資活動を制限し、懸念主体との共同研究・技術ライセンスを制限する条項である。特に米国と中国の双方を市場とする日本企業は、CHIPS法に基づく助成金を受ける場合、中国ビジネスが大きく制限される可能性がある。

II. 半導体分野のムチ

半導体分野を巡る輸出管理は、近時急激に厳格化している。主として米国が主導して輸出管理を厳格化してきたが、近時では米国が日本を含む同志国と連携をすることで、マルチナショナルに輸出管理制度が厳格化されつつある。

米国では対中輸出管理である旨を明記する規制内容となっているが、日本では中国向けであることが法律上は明記されていない。地政学上の位置づけや現実的な紛争発生リスクなどの違いから、日本では中国を

刺激するようなアプローチが採用しづらいという背景がある。

1. 日本における半導体分野の輸出管理

半導体製造装置等の23品目について輸出管理を厳格化する輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（以下「貨物等省令」という。）及び関連通達の改正（以下「本改正」という。）が2023年5月23日に公布され、同年7月23日から施行される。貨物等省令は、日本における輸出管理制度の根拠法令である外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）の下位法令にあたり、輸出管理対象となる品目の詳細を定めている。

(1) 半導体分野における従前の輸出管理の状況

半導体・原材料および半導体製造装置等については、従前から、安全保障貿易管理の枠組みで輸出管理が行われてきた。

日本をはじめとする主要国では、武器や軍事転用可能な貨物・技術が、日本および国際社会の安全性を脅かす国家やテロリスト等、懸念活動を行う恐れのある者に渡ることを防ぐため、国際的な枠組み（国際輸出管理レジーム）を作り、国際社会と協調して輸出等の管理を行っている。具体的に、日本では、外為法第48条1項および第25条1項に基づき管理対象となる貨物の輸出や技術の提供について経済産業大臣の許可にかからしめている。日本におけるこのような国際的な平和および安全の維持の観点に立った取り組みを一般に安全保障貿易管理という。

冷戦終結後の日本における安全保障貿易管理では、原則、国際輸出管理レジームに基づく輸出管理が行われており、半導体分野については、ワッセナー・アレンジメントに準拠した輸出管理が行われてきた。

(2) 本改正の内容

本改正で追加の管理対象とされた品目は、いずれも国際輸出管理レジームで規制されていない品目である。本改正は、ワッセナー・アレンジメントで規制品目とされていない品目について管理をおこなっており、国際輸出管理レジーム外の品目を管理する点で歴史的な転換点といえる。

2023年3月31日に行われた西村康稔経済産業大臣による会見（以下「西村大臣会見」という。）では、

本改正は「厳しさを増す国際的な安全保障環境を踏まえて、軍事転用の防止を目的として、ワッセナー・アレンジメントを補完するとともに、半導体製造装置に関する関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案して」規制するものであるとして、国際輸出管理レジームを補完する目的で国際輸出管理レジーム外の品目を規制する旨説明をしている。

この背景には、2023年1月27日に報道があった^{注2}、日本、米国およびオランダによる半導体製造装置等に関する対中輸出管理の実施合意があるものと考えられる。なお、政府の公式な見解としては、西村大臣会見において、本改正は「アメリカ、オランダを含む同盟国、同志国との意見交換を行ってきているところであり、そうした意見交換を踏まえながら、わが国として必要と考える措置を導入するもの」であるとして、日米蘭合意への直接の言及を避けている。

本改正では、半導体製造装置について、露光装置、エッチング装置、成膜装置、アニール装置（加熱装置）、洗浄装置等が規制されており、半導体製造工程における前工程に利用される装置が広く規制されている。加えて、半導体製造装置のみならず、マスク検査装置、EUV用ペリクル、EUV用ペリクル製造装置も規制対象とされている。

実務上は、本改正で管理対象となる品目（EUV用ペリクルを除く）の部分品・附属品も管理対象とされている点も重要となる。本改正で管理対象となる品目そのものを取り扱わない場合であっても、その部分品・附属品を製造する場合には、本改正に基づく規制に留意する必要がある。また、貨物のみではなく、本改正で管理対象となる品目（EUV用ペリクルを除く）の設計・製造に必要な技術および設計・製造・使用するために設計したプログラムならびにEUV用ペリクルを設計・製造するために設計したプログラムも規制されている。

2. 米国における半導体分野の輸出管理

2022年10月7日に公布された米国輸出管理規則（Export Administration Regulations、以下「EAR」という。）の改正では、Entity Listなどの懸念主体リストを拡充するほか、特に高性能な半導体の製造・開発等に焦点を当て、エンドユース規制の強化・新規規制品目の追加などが行われた（以下「本EAR改正」という。）。

本EAR改正の内容を大別すると①直接製品規制の拡大、②エンドユース規制の拡大、③US personに着

目した規制類型の追加、④新規規制品目の追加、⑤懸念主体リストの拡大に分類できる。

個別の詳細に入ることは避けるが、特に注目すべきは、EARの域外適用の範囲を拡大させていることである。すなわち、直接製品規制とは、米国原産の技術・ソフトウェアを用いて外国において製造した製品についても、EARの規制対象とする制度であるが、直接製品規制の範囲が拡大されると、米国外で半導体を製造する外国企業にも影響が及ぶ。また、US personに着目した規制類型では、US personと定義される米国人・米国企業等が一定の取引の促進行為等を行うことを制限しているところ、日本企業の米国子会社や雇用する米国籍の技術者に対しても影響がある。

そのため、米国に拠点をもたない日本企業や一見米国を介さない取引であっても、米国の輸出管理制度の遵守が求められる場合があり、米国の動向にも注視する必要がある。

注1：第208回国会 衆議院 内閣委員会 第3号 令和4年2月9日。

注2：「日本とオランダ、米の対中半導体規制への参加に同意-関係者」米ブルームバーグ通信、2023年1月27日。

（筆者略歴）

2016年弁護士登録（第二東京弁護士会所属）。森・濱田松本法律事務所での勤務を経て、2019年から任期付公務員として経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課、安全保障貿易管理政策課および同国際投資管理室ならびに大臣官房経済安全保障室にて勤務。2021年12月より森・濱田松本法律事務所に復帰。クロスボーダーM&Aを含む国際取引やそれに伴う平時・有事の規制法アドバイスを取り扱う。特に外為法をはじめとする経済安全保障法制に詳しく、日米欧中を含む主要国の投資管理、貿易管理、機微技術管理、経済制裁等に知見を有する。また、ビジネスと人権の観点から企業が直面する人権問題へのアドバイスも行う。スペイン語を使用言語とすることから、スペインおよび中南米法務も多く取り扱っている。

著書に『外為法に基づく投資管理-重要土地等調査法・FIRMAも踏まえた理論と実務』（中央経済社、2022年3月、単著）など。

